

令和6（2024）年度熊本大学工学部半導体デバイス工学課程の新設に伴う3年次編入学試験について（予告）

令和5年3月29日
熊本大学

本予告は、現時点で計画中的のものであり、本予告に掲載する課程名称等については今後変更になる可能性があります。

（1）工学部半導体デバイス工学課程の設置

熊本大学では、2030年の社会を見据え、「熊本大学イニシアティブ2030」を策定し、DX（デジタルトランスフォーメーション）時代の国際社会に対応できるリテラシーを身に付け、高度な英語力と異文化理解の力によりSDGsの達成に貢献できるグローバル人材の育成を目指し、様々なプロジェクトに取り組んでいます。

また、半導体分野のグローバル企業の熊本進出を契機として、半導体分野における人材需要が高まっている中、地域に根差す国立大学として、その高度人材を輩出することは責務と考え、教育・研究の取組を加速化しています。

この度、熊本大学は、半導体デバイスの製造・評価・開発に携わることのできる人材を育成する「工学部半導体デバイス工学課程」の新設を計画し、その設置準備を進めています。

「工学部半導体デバイス工学課程」では、半導体デバイスの製造過程における基盤的専門知識を備え、半導体デバイスの製造・評価・開発に携われる人材として、半導体関連エンジニアとして熊本から世界で活躍する人材を育成することに加え、工学部他学科と同様、大学院自然科学教育部博士前期課程と連携した6年一貫の教育プログラムとして整え、専門性をさらに深化することを可能としています。

（2）募集人員

工学部3年次編入学試験における半導体デバイス工学課程の募集人員等は、以下のとおりです。

○現行

工学部	土木建築学科	10
	機械数理工学科	10
	情報電気工学科	20
	材料・応用化学科	5

○新設後

工学部	土木建築学科	10
	機械数理工学科	10
	情報電気工学科	20
	材料・応用化学科	5
	半導体デバイス工学課程	20

合計45名 → 合計65名

（3）入学試験時期

- 土木建築学科、機械数理工学科、情報電気工学科、材料・応用化学科

推薦入試：令和5年5月 一般入試：令和5年7月

- 半導体デバイス工学課程

一般入試：令和5年10月～11月頃（予定）

本予告は、現時点で計画中的のものであり、掲載している課程名称等については今後変更になる可能性があります。

確定後の内容については、熊本大学工学部のホームページ等で必ず確認してください。

【本件に関するお問い合わせ先】

熊本大学 自然科学系事務課 工学部教務担当
電話番号 096-342-3522